

# 鉛フリーはんだシンポジウム

JISに基づく鉛フリーはんだ共同試験報告

と規格化・EU動向の最新情報

JWES

日時：平成16年10月6日（水）9:30～17:00

会場：芝浦工業大学 芝浦校舎 大講義堂

## 開催趣旨

WEEE にかかわる EU 指令での有害物質規制（RoHS）が2006年7月より発効することから、電機・電子機器メーカーでは【鉛フリーはんだ】への対応が急ピッチで進んでいます。

しかし、製品の設計寿命に関わる【鉛フリーはんだ継手】の信頼性に最も影響を与える【鉛フリーはんだ材料】の材料特性に関するデータは、まだ十分に把握できていません。

【鉛フリーはんだ継手】の信頼性すなわち【鉛フリーはんだ付の信頼性】を確保するには、そのベースとなる【鉛フリーはんだ材料】の「熔融温度範囲」、「機械特性」、「ぬれ性」などを十分に把握し適切な条件ではんだ付しなければなりません。

【鉛フリーはんだ継手】の信頼性を確保するためには、【鉛フリーはんだ】の材料特性を十分に検証し、組成による物性値の違いを検討し、最も製品の設計寿命に適した【鉛フリーはんだ】を選択することが重要です。

現在、はんだ研究委員会では、ISO、IEC に日本から提案している20種類以上の【鉛フリーはんだ】材料について、2003年6月に制定されたJIS Z 3198「鉛フリーはんだ試験方法」を用いて【鉛フリーはんだ材料】の物性値のデータベースを構築するための共同試験を行っています。

今回その成果の一部を紹介すると共に【鉛フリーはんだ】に関連するJIS、ISO、IECなどの規格化の最新情報とEUにおけるWEEE、RoHSなどの最新動向について御紹介することを目的にシンポジウムの開催を企画いたしました。関係各位の参加を是非お勧め致します。

主催 社団法人 日本溶接協会

はんだ研究委員会

マイクロソルダリング教育委員会

後援 社団法人 電子情報技術産業協会（依頼中）

JWES



# PROGRAM

9:30 ~ 9:35	開会挨拶 (はんだ研究委員会 竹本委員長)		
9:35 ~ 9:45	来賓挨拶 (経済産業省)		
9:45 ~ 10:20	世界の鉛フリーはんだ規格化最新状況		
9:45 ~ 9:55	鉛フリーはんだ関連規格体系の概要	大阪大学 接合科学研究所 竹本 正 氏	
9:55 ~ 10:15	JIS ISO IECにおける鉛フリーはんだ関連規格の最新状況	千住金属工業(株) 鶴田 加一 氏	
10:15 ~ 11:45	JIS Z 3198試験方法に基づく鉛フリーはんだ材料の共同試験結果		
10:15 ~ 10:55	鉛フリーはんだの熔融温度範囲測定結果とその勘所	内橋エステック(株) 浜田 好人 氏	
10:55 ~ 11:45	鉛フリーはんだの強度特性試験結果	(株)ニホンゲンマ 萩尾 浩一 氏	
11:45 ~ 12:45	昼食休憩		
12:45 ~ 14:15	より良い試験方法を目指した新規提案		
12:45 ~ 13:15	微小試験片による引張試験の提案	独立行政法人物質・材料研究機構 苅谷 義治 氏	
13:15 ~ 14:15	ひずみ速度変化引張試験方法による鉛フリーはんだ信頼性の推定	大阪大学 工学研究科 安田 清和 氏	
14:15 ~ 14:30	休 憩		
14:30 ~ 15:30	欧州のWEEE & RoHS関連緊急報告2件		
14:30 ~ 15:00	Electronics goes Greenにみる世界の鉛フリーはんだ研究最前線	大阪大学 接合科学研究所 西川 宏 氏	
15:00 ~ 15:30	IPC/SOLDERTEC第2回鉛フリー国際会議(アムステルダム)におけるRoHS最新状況	(株)日立製作所 生産技術研究所 岡本 正英 氏	
15:30 ~ 16:45	JEITA鉛フリーはんだ関連試験方法の規格化プロジェクト		
15:30 ~ 16:15	IEC鉛フリー標準化ロードマップ JEITA鉛フリーはんだ実用化検討2004年報告会概略	ソニー(株)	荒金 秀幸 氏
16:15 ~ 16:45	JEITAにおける部品ぬれ性試験方法の ソルダペーストへの適用可能性	山陽精工(株)	平本 清 氏
16:45 ~ 17:00	総括質疑応答と閉会の挨拶		

シンポジウム企画世話人：

竹本 正(大阪大学接合科学研究所) / 藤本 公三(大阪大学大学院工学研究科) / 大塚 正久(芝浦工業大学工学部)

プログラムの内容は若干変更になる場合がありますので予めご了承下さい。  
最新詳細情報は下記ホームページを参照願います。

[http://www.jwes.or.jp/jp/ab\\_jwes/kenkyu/solder/index.html](http://www.jwes.or.jp/jp/ab_jwes/kenkyu/solder/index.html)



## 参加申込方法

申込書に必要事項を記入し、下記申込先に郵送またはファックスでお申し込み下さい。

受付後、FAXにて参加証を送付いたしますので、シンポジウム当日は必ず参加証をお持ち下さい。  
FAX番号は必ずご記入下さい。

参加定員：定員220名（定員になり次第締め切りま

参加費用：18,000円 / 1名（資料代および消費税を含む） 振込手数料は、各自ご負担下さい。

振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 146921 (社)日本溶接協会

参加費用は上記の口座にご送金下さい。銀行口座への振込をもって領収にかえさせていただきます。  
また、納入された参加費は返却いたしかねますのでご了承下さい。なお、参加費用の振り込みが、シンポジウム当日以後になる場合は、必ず申込書の振込予定日をご記入下さい。

申込先：〒101-0025 東京都千代田区佐久間町1-11 (社)日本溶接協会

担当：業務部 白倉 TEL：03-3257-1524 FAX：03-3255-5196



## 会場案内

JR山手線・京浜東北線・田町駅東口より徒歩3分、または都営三田線三田駅より徒歩5分

〒108-8548 東京都港区芝浦 3-9-14



F A X 03-3255-5196 社団法人 日本溶接協会 業務部 白倉宛

## 鉛フリーはんだシンポジウム

JISに基づく鉛フリーはんだ共同試験報告と規格化・EU動向の最新動向

### 参加申込書

1	ふりがな		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (所属先名)	ふりがな		
	TEL ( )	FAX ( )	e-mail :
	〒		
同上 所在地			

2	ふりがな		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (所属先名)	ふりがな		
	TEL ( )	FAX ( )	e-mail :
	〒		
同上 所在地			

振込予定日 平成 年 月 日 頃

振込金額 ¥

振込手数料は、各自ご負担下さい。

請求書及び領収書の発行は致しません。社内処理は、銀行発行の振込領収書でお願いいたします。